

# エッチング装置

## エッチングとは？

エッチング工程は、ウェーハ上に回路を描くリソ工程が完了した後に、不要な薄膜を除去して半導体のパターンを残す工程のことを指します。

エッチングにはドライエッチングとウェットエッチングとがあり、半導体では主にドライエッチングが使われます。

ドライエッチングでは真空容器内で腐食性ガスをプラズマ化し、化学反応と加速したイオンで薄膜を削って除去します。

